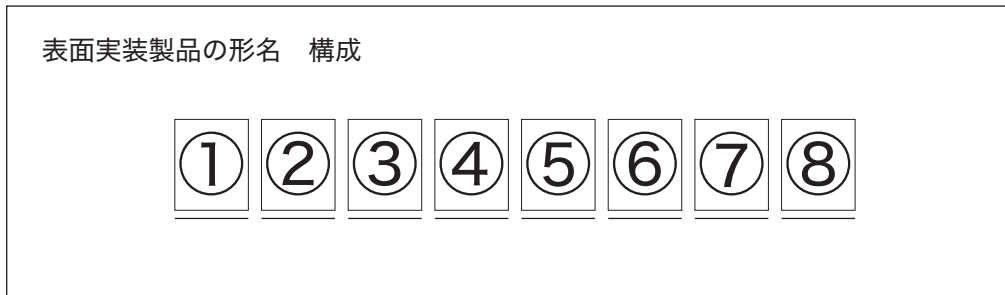


## ■ 表面実装 (SMD) 製品の形名について

当社の表面実装 (SMD) 製品の形名体系は、以下の如く設定しております。



- ① NDK を示す記号 : N
- ② 製品を示す製品記号 : 表 1 参照

表 1 製品を示す記号

製品記号	製品
X	水晶振動子
T	温度補償水晶発振器 (TCXO)
H	恒温槽付き水晶発振器 (OCXO)
V	電圧制御水晶発振器 (VCXO)
P	パッケージ水晶発振器 (SPXO)
Z	クロック用水晶発振器
M	モノリシック・フィルタ
S	SAW デバイス

- ③④ 製品本体の長手方向の公称寸法 (mm) を 2 桁で示す。3 桁目は四捨五入
- ⑤⑥ 製品本体の短手方向の公称寸法 (mm) を 2 桁で示す。3 桁目は四捨五入  
【例】 6.0mm×3.5mm の場合 6035 とする。  
11.8mm×5.5mm の場合 1255 とする。
- ⑦ 構成材料、封止方法を示す記号 : 表 2 参照

表 2 封止方式記号

製品封止区分	記号	製品封止方法	パッケージ材料	
			ベース	カバー
密封封止	C	接着剤封止	セラミック	
	M	樹脂モールド	樹脂	
	P	接着剤封止	樹脂	
	G	ガラス封止	セラミック	
	R	抵抗溶接封止	セラミック	金属
	S, D	シーム溶接	セラミック	金属
非密封封止	A	金錫封止	セラミック	金属
	W	—	基板	金属
	X	—	基板	非金属
	Y	—	モールド	金属
Z	—	モールド	非金属	
その他	B	プリント基板に複数の水晶素子を搭載実装し、上面に銘板を貼り付けたもの。		

- ⑧ 形名登録順の詳細番号 : A~Z  
尚、リード挿入実装タイプとして設計された製品を、2 次加工により表面実装用に転用するものは、従来どおり、2 次加工前の製品形名群と致します。